9802156-1
IPOS copy

世界知的所有権機関
国際事務局

PCT

特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(51) 国際特許分類6 **H01L 21/60, 21/52, C01G 37/033**	**A1**	(11) 国際公開番号 **WO98/01902** (43) 国際公開日 1998年1月15日(15.01.98)

(21) 国際出願番号 PCT/JP97/02335

(22) 国際出願日 1997年7月4日(04.07.97)

(30) 優先権データ
特願平8/178123 1996年7月8日(08.07.96) JP
特願平8/182183 1996年7月11日(11.07.96) JP

(71) 出願人
株式会社 東芝(KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA)[JP/JP]
〒210 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 Kanagawa, (JP)
(72) 発明者
武浪幸宏(TAKENAMI, Yukihiro)
〒104 東京都中央区新川2-27-4-1605 Tokyo, (JP)
矢部久雄(YABE, Hisao)
〒254 神奈川県平塚市高村26-37-307 Kanagawa, (JP)
佐藤孔俊(SATO, Yoshitoshi)
〒235 神奈川県横浜市磯子区東町18-8-513 Kanagawa, (JP)
千田忠一(CHIDA, Tadakazu)
〒242 神奈川県大和市福田1-19-6 Kanagawa, (JP)

(74) 代理人
弁理士 波多野久, 外(HATANO, Hisashi et al.)
〒105 東京都港区西新橋一丁目17番16号
宮田ビル2階 Tokyo, (JP)

(81) 指定国 KR, SG.

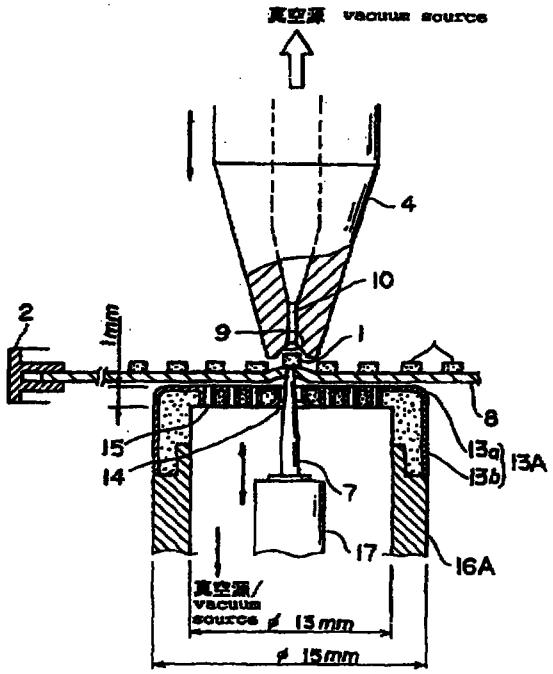
添付公開書類
国際調査報告書

(54)Title: **SEMICONDUCTOR COMPONENT FIXING JIG, TABLE FOR PLACEMENT OF SEMICONDUCTOR COMPONENT AND BONDING APPARATUS**

(54)発明の名称 半導体部品固定治具、半導体部品載置用受台およびボンディング装置

(57) Abstract

A semiconductor component fixing jig and a table for the semiconductor component include a coating layer formed on the surface of a metal base and made of a chromium oxide as a principal component. Further, the chromium oxide is a chromic oxide (Cr_2O_3) having a mean particle diameter of 0.1 to 0.5 μm. A bonding apparatus of this invention is constituted by using the semiconductor component fixing jig and the table described above. According to this construction, it is possible to obtain a semiconductor component fixing jig, a table and a bonding apparatus having excellent wear resistance, capable of reducing occurrence and deposition of dust due to peel of a coating material, and capable of correctly recognizing coordinates positions of leads, and the like, at the time of bonding.



（５７）要約

本発明に係る半導体部品固定治具および受台は、金属母材表面にクロム酸化物を主成分とする被覆層を形成したことを特徴とする。またクロム酸化物が酸化第二クロム（Cr_2O_3）であることを特徴とする。さらにクロム酸化物は平均粒径が０．１～０．５μｍの酸化第二クロム（Cr_2O_3）微粒子であることを特徴とする。また本発明に係るボンディング装置は、上記半導体部品固定治具や受台を使用して構成される。上記構成によれば、耐摩耗性が良好であり、被覆物の剥離による粉塵の発生付着を低減でき、さらにボンディングの際にリード等の座標位置を正確に認識することが可能な半導体部品固定治具や受台およびボンディング装置が得られる。

参考情報

ＰＣＴに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に記載されたＰＣＴ加盟国を同定するために使用されるコード

AL	アルバニア	ES	スペイン	LR	リベリア	SG	シンガポール
AM	アルメニア	FI	フィンランド	LS	レソト	SI	スロヴェニア
AT	オーストリア	FR	フランス	LT	リトアニア	SK	スロヴァキア共和国
AU	オーストラリア	GA	ガボン	LU	ルクセンブルグ	SL	シエラレオネ
AZ	アゼルバイジャン	GB	英国	LV	ラトヴィア	SN	セネガル
BA	ボズニア・エルツェゴビナ	GE	グルジア	MC	モナコ	SZ	スワジランド
BB	バルバドス	GH	ガーナ	MD	モルドヴァ共和国	TD	チャード
BE	ベルギー	GM	ガンビア	MG	マダガスカル	TG	トーゴ
BF	ブルギナ・ファソ	GN	ギニア	MK	マケドニア旧ユーゴスラヴィア共和国	TJ	タジキスタン
BG	ブルガリア	GR	ギリシャ	ML	マリ	TM	トルクメニスタン
BJ	ベナン	HU	ハンガリー	MN	モンゴル	TR	トルコ
BR	ブラジル	ID	インドネシア	MR	モーリタニア	TT	トリニダード・トバゴ
BY	ベラルーシ	IE	アイルランド	MW	マラウイ	UA	ウクライナ
CA	カナダ	IL	イスラエル	MX	メキシコ	UG	ウガンダ
CF	中央アフリカ共和国	IS	アイスランド	NE	ニジェール	US	米国
CG	コンゴー	IT	イタリア	NL	オランダ	UZ	ウズベキスタン
CH	スイス	JP	日本	NO	ノルウェー	VN	ヴィェトナム
CI	コート・ジボアール	KE	ケニア	NZ	ニュー・ジーランド	YU	ユーゴスラビア
CM	カメルーン	KG	キルギスタン	PL	ポーランド	ZW	ジンバブエ
CN	中国	KP	朝鮮民主主義人民共和国	PT	ポルトガル		
CU	キューバ	KR	大韓民国	RO	ルーマニア		
CZ	チェッコ共和国	KZ	カザフスタン	RU	ロシア連邦		
DE	ドイツ	LC	セントルシア	SD	スーダン		
DK	デンマーク	LI	リヒテンシュタイン	SE	スウェーデン		
EE	エストニア	LK	スリランカ				